

投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2024-004〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中泰证券、大和证券、国信证券、西部证券、华安证券、东吴证券、天风证券、寻常投资、盘京投资、鹏华基金、睿思资本、长盛基金、中加基金、泓德基金、原点资产、肇万资产、晨燕资产、呈瑞投资、立元集团、惠通基金、创富兆业、华宝基金、同方证券、嘉合基金、南银理财、瑞华控股、华泰证券、上海人寿、弘则研究、西部证券、钦沐资产、中国太平、青骊投资、凯丰投资、广发证券、景顺长城基金、农银汇理基金、易方达基金、金仕达投资、山西证券、嘉实基金、海富通基金、信达澳亚基金、东方财富证券、天壹紫腾资产、希瓦私募基金、人保资产基金、申万宏源证券、汇丰晋信基金、兴证全球基金、华能贵诚信托、证国私募基金、Hel Ved Capital Management Limited、Pinpoint Asset Management Limited
时间	2024-4-30及2024-5-6
地点	线上交流
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节 Q: 目前市场上有一些关于碳化硅衬底价格调整的新闻，请问公司如何看待这件事？ A: 随着市场空间的扩大以及良率水平的提升，会不可避免地在市场竞争过程中出现价格的调整，这在短期内会对行业相关企业造成一些压力。但从我们作为产业链上游的设备供应商角度来看，

良率的提升和价格的下浮对整个产业链利大于弊。成本的下降将推动更多下游应用的涌现，从而使得行业整体保持一个良好的增长速度。

Q: 请问国内碳化硅大尺寸化的趋势是否明显？

A: 目前碳化硅行业正处于从6英寸向8英寸转型的阶段，8英寸替代6英寸的速度将快于预期。我们注意到，国外行业龙头企业的新增订单和远期布局都已转向以8英寸为主。在国际市场的推动下，我们的国内客户也开始结合自身的技术进步和良率水平，在新产能布局方面做适当的调整。

Q: 公司的8英寸碳化硅设备是否已量产？6英寸转8英寸的趋势是否已在公司的在手订单中体现？

A: 公司8英寸碳化硅长晶设备已实现批量出货。从目前在谈项目来看，客户对于8英寸设备存在更大的意向和需求。但由于公司并没有把未收到预付款的部分纳入在手订单统计范围，因此一部分8英寸设备的需求暂时还未统计在在手订单中。

Q: 对于公司碳化硅相关其他设备，特别是外延炉和切割机方面，相信在今年也能看到不错的进展，能否展开介绍一下这两个新产品的进展？

A: 从两年前开始，我们对于合作客户端仍存在进口依赖的部分重点产品进行了布局，这里就包括了您刚才提到的碳化硅外延炉以及切割机。这两种产品在整个碳化硅产业里，也是较为核心的重要设备。在外延方面，我们早期对市场主流的设备进行了深入调研，最终选择了单片机和多片机两个路线同步进行。目前国内以单片机为主，其工艺制程相对成熟，因此可以迅速上手并有效产出；多片机在国内的使用经验仍然较少，但一旦多片的外延工艺能够实现突破的话，它的良率、成本和产出效率的优势是最大的。公司现已完成了外延设备样机的前期开发工作，计划在内部进行相关的测试后，送往客户端进行工艺验证。切割设备方面，我们采用了砂浆和金刚线兼容的设计，公司内部的试切工艺测试效果良好，设备现已发往客户。接下来，对于这两类产品，我们会加大与客户工艺测试的合作和效率，争取今年达到量产水平，以进入行

业的第一梯队为未来目标。

Q: 半导体硅单晶炉去年受到周期性影响, 收入确认相对较少。我们对2024年硅片业务的整体情况有何展望? 对于高质量硅片的需求, 我们目前是否已经具备了相应的设备储备和供应潜力?

A: 根据了解到的市场情况, 硅行业的库存水平已经得到一定程度的降低。同时, 随着高算力HBM对于存储用芯片的需求拉动、以及华为手机对于芯片国产化率的提升, 整个国内产业链也受到了巨大的推动。公司在这一两年间继续加大了硅产品的研发投入。我们对设备的现有控制系统进行了升级, 包括新的横拉速控制的算法和新功能的实施, 这些都是生产高品质硅单晶的重要保证因素。另外, 我们计划今年向市场推出高端存储抛光片和超低氧包括SOI这种高规格硅片对应的设备。我们产品的热场的新设计、工艺控制的能力以及算法系统的优化等方面都已具备匹配行业领先的下游硅片厂所要求的设备技术水平。再结合客户对于原先暂停或延期的扩产计划的更新, 我们预计今年会在硅业务方面取得新的进展。